

证券代码：301297

证券简称：富乐德

安徽富乐德科技发展股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-005

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	2026年9月9日上午： 王凯、刘洋 爱建证券 杨红、颜枫 富安达基金 朱之轩 和谐健康保险 游凡 宝盈基金 赵万隆 长盛基金 王亚琪 银叶投资 林威克 轩汉投资 郑奥 东北证券 张真桢、姚依念 国金证券 2026年9月9日下午： 贾国瑞 国联民生证券 陆坚、刘兵、吴涛 太平养老保险 刘洋 人保资产 钱博文 建投基金 王帅 富国基金 唐栩 前海开源基金 陈琛 华宝基金 吴伯珩 平安养老 张世杰 毕盛投资

	乌焕强 华夏基金
时间	2026年09月09日 9:30 2026年09月09日 14:00
地点	腾讯会议（2026年09月09日 9:30） 江苏富乐华半导体科技股份有限公司（2026年09月09日 14:00）
上市公司接待人员姓名	2026年09月09日 9:30 董事会秘书 颜华 富乐华投资部长 刘立波 证券事务代表 李海东 2026年09月09日 14:00 富乐华投资部长 刘立波
投资者关系活动主要内容介绍	1、请简要介绍公司目前的主营业务布局。 答：公司围绕“泛半导体设备精密洗净+半导体核心零部件材料”双轮驱动战略进行布局，主要有三大业务板块：一是泛半导体设备精密洗净服务，包括半导体、TFT、OLED设备的精密洗净、检测及阳极氧化、陶瓷熔射等衍生增值服务；二是功率半导体覆铜陶瓷载板业务，包括DCB、AMB、DPC等产品；三是半导体核心零部件业务。三大板块协同共振，共同构建公司“服务+材料+部件”的综合解决方案能力。 2、公司半导体设备洗净服务覆盖哪些工序和客户？ 答：主要覆盖集成电路制造过程中的氧化/扩散（扩散炉、氧化炉、外延生长设备）、光刻（溶胶显影设备、涂胶设备）、刻蚀（介质、金属、边缘刻蚀设备）、离子注入、薄膜生长（金属沉淀设备、介质层沉积设备、原子层沉积设备、电镀设备）、机械抛光等设备均系公司洗净服务对象，几乎涵盖集成电路2/3工序的生产设备定期维护。公司半导体设备清洗服务覆盖了大部分中国大陆地区在运营的6英寸、8英寸、12英寸的晶圆代工产线，与中芯国际、华力集成、华力微电子等国内行业巨头建立了长期稳定的合作关系。除半导体生产厂商外，公司还与世界主要半导体设备厂商（泛林集团、应用材料、东京电子）开展合作。 3、公司洗净业务当前的产能利用率和扩产进展如何？ 答：受下游晶圆制造企业持续扩产及AI芯片需求带动，当前国内主要洗净工厂产能利用率维持高位。公司将持续推进产能扩张，生产基地将从现有布局进一步扩充，同时持续提升高制程洗净能力，匹配下游7nm、5nm、3nm等高端制程发展需求。此外公司拟向不特定

	对象发行可转债，募集资金总额不超过11.76亿元，拟用于大连富乐德精密洗净及再生服务产线建设项目、精密洗净及再生服务基地（上海临港）建设项目、精密洗净及再生服务基地（深圳）建设项目、精密洗净及再生服务基地（武汉）建设项目等七大项目，总投资额合计约15.87亿元，进一步完善全国产能布局。 4、公司覆铜陶瓷载板业务核心产品矩阵是怎么样的？ 答：公司全资子公司富乐华专注于覆铜陶瓷载板领域，拥有近三十年研发生产经验，是国内外少数实现全流程自制的覆铜陶瓷载板生产商，产品覆盖DCB、AMB、DPC三大品类。DCB产品采用铜箔直接高温烧结工艺，具备优秀的热循环性、高机械强度和高导热率，主要配套硅基器件，应用于新能源汽车、工业控制、智能家电、光伏及风力发电等领域；AMB产品采用活性金属钎焊工艺，结合强度更高、可靠性更优，适配碳化硅器件，应用于新能源汽车800V高压平台、轨道交通、AI服务器电源等高功率场景；DPC产品通过磁控溅射和图形电镀实现陶瓷表面金属化，具备高线路精度和可垂直互连特性，主要面向光模块TEC热电制冷、激光雷达、光通信等高端应用领域。 此外，富乐华提前布局上游瓷片等关键材料，有助于降低生产成本、实现供应链自主可控。 5、覆铜陶瓷载板产品的主要客户和应用领域是什么？ 答：DCB产品主要客户包括比亚迪、英飞凌、斯达半导、士兰微、富士电机等国内外功率半导体领先企业，终端主要应用于工业控制、家用电器、光伏、风力发电等领域。AMB产品主要客户为意法半导体、博格华纳、比亚迪、中车时代、富士电机等行业知名企业，终端主要应用于新能源汽车、动力机车领域。DPC产品主要应用于激光制冷器，未来在工业激光、车载激光、光通信等高端应用领域拥有广阔的应用前景。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026年09月14日